ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ ПОДЛОЖКИ

Номакон Nomacon

Керамико-полимерный материал **«Номакон-Gs»** применяется для изолирования посадочных поверхностей полупроводниковых элементов при монтаже, а также как диэлектрический материал в электронике, термотехнике и электротехнике.

ОСОБЕННОСТИ

- Интенсивный отвод тепла от нагреваемой поверхности
- Монтаж полупроводниковых элементов без нанесения теплопроводящего компаунда, что гарантирует чистоту и сокращает время сборки
- Высокая эластичность, обеспечивающая надежный контакт в соединении полупроводник-подложка-радиатор
- Снижение себестоимости за счет уменьшения трудоемкости сборки и замены дорогостоящей керамики
- Экологическая чистота

ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВТУЛКИ

- Обеспечивают изоляцию полупроводниковых приборов от корпуса радиатора при креплении винтами
- Материал – полипропилен
- Внутренний диаметр – 2.5 мм

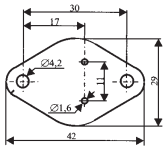
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельное объемное сопротивление: ..... 1014 Ом×см
Теплопроводность: ..... 1-2 Вт/(м×К)
Пробивное напряжение: ..... 3.0 кВ
Тангенс угла потерь (при 1000 Гц): ..... $(4\text{-}4.5)10^{-3}$
Диапазон рабочих температур: ..... -60...+260 °С

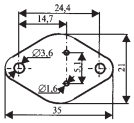
ПОСТАВКА

- Листами 220×140, 140×135 мм толщиной 0.22 мм
- В виде готовых подложек под стандартные и нестандартные корпуса
- По желанию заказчика возможно изготовление подложек требуемой формы, размера и толщины

ТИПЫ ПОДЛОЖЕК

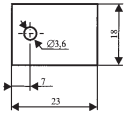


1A4229

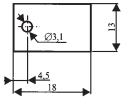


1A3521

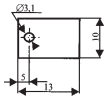
3A1261



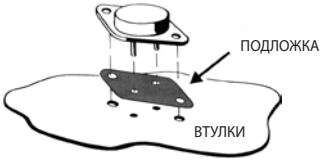
2A2318



2A1813



2A1310



Тип корпуса транзистора	Наименование
ТО3	1A4229
ТО66	1A3521
ТО126	2A1310, 2A1209
ТО220	2A1813
ТО218, 247	2A2318
Нестандартный	2A2116
Нестандартный	2A1510
Нестандартный	2A3025
Нестандартный	2A2221
Нестандартный	2A4223
Нестандартный	2A1261
Нестандартный	2A1651

ТУ РБ 14576608.003-96